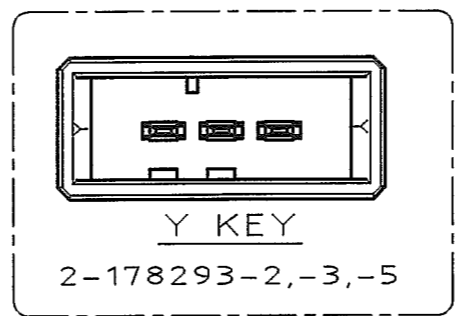
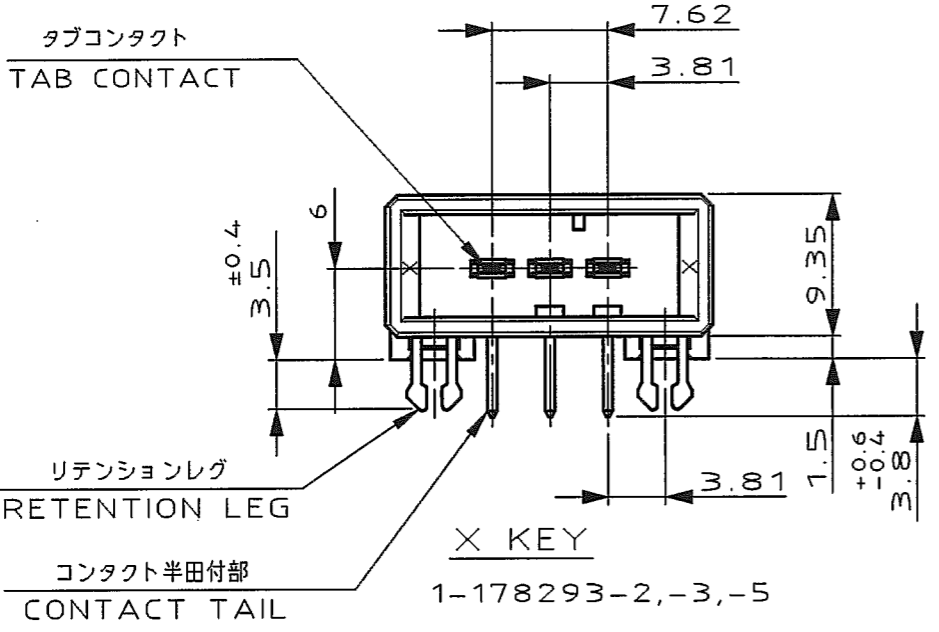
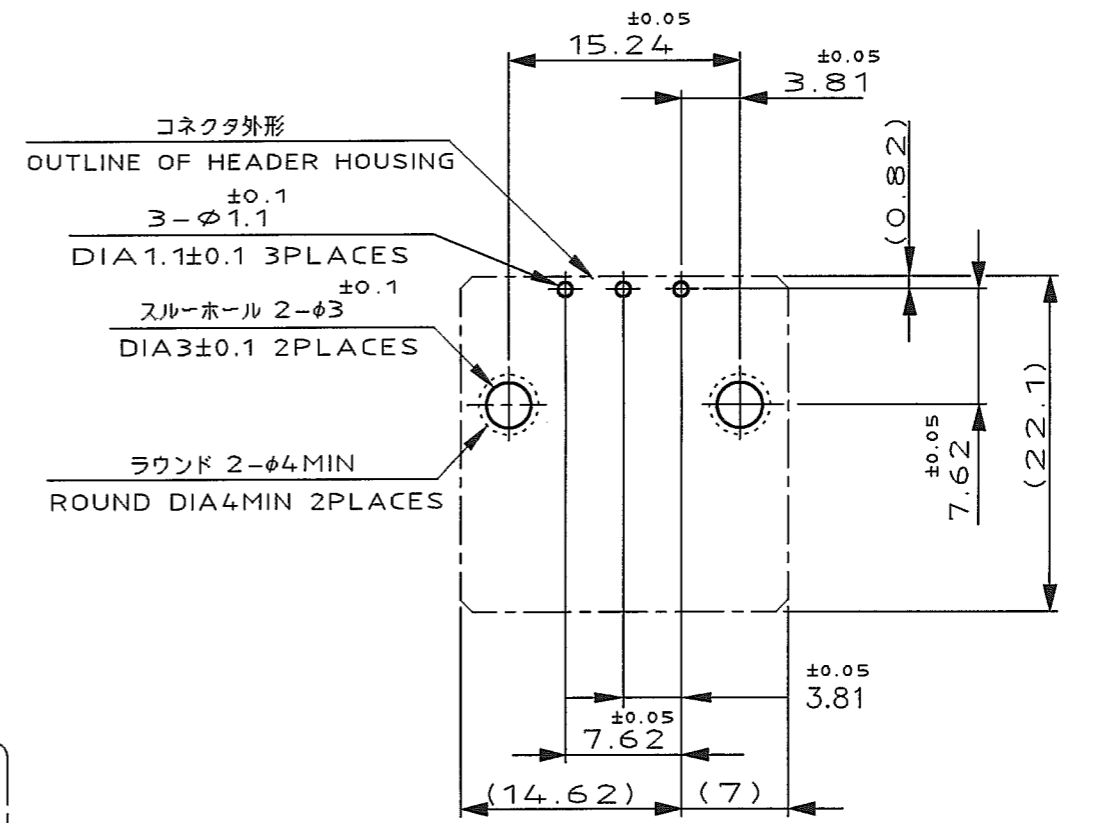
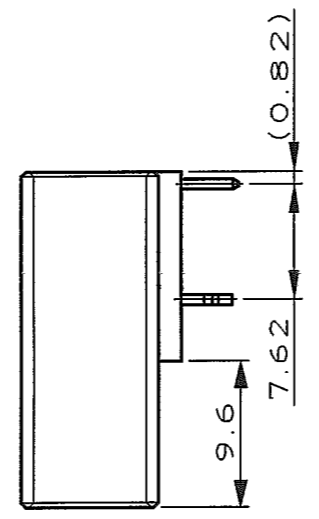
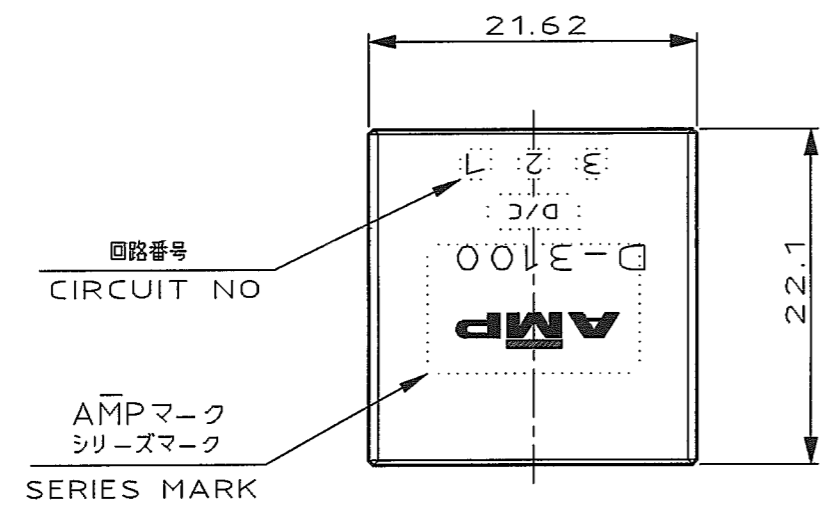


NUMBER 178293
 METRIC
 DIMENSIONS IN MILLIMETERS. DO NOT SCALE PRINT
 PRINT DIST



推奨基板取付け穴寸法
 PC 基板厚: 1.6±0.1
 (非累積公差)
 (コネクタ搭載面)

RECOMEND PC BOARD HOLE PATTERN
 PC BOARD THICKNESS: 1.6±0.1
 (NOT ACCUMULATE TOLERANCE)
 (CONNECTOR MOUNT SIDE)

NOTES

1. MATERIAL: HOUSING: GLASS FILED THERMO PLASTIC, POLYESTER
 CONTACT: COPPER ALLOY
 RETENTION LEG: COPPER ALLOY
2. FINISH (CONTACT AREA): 0.38μm MIN GOLD PLATING OVER Ni PLATING
3. FINISH (CONTACT AREA): 0.76μm MIN GOLD PLATING OVER Ni PLATING
4. FINISH (CONTACT AREA): 2.0 μm MIN TIN PLATED OVER NICKEL
5. FINISH (RETENTION LEG): TIN-LEAD PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL
6. FINISH (RETENTION LEG): TIN PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL

注記

1. 材料: ハウジング: ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂
 コネクタ: 銅合金
 リテンションレグ: 銅合金
2. めっき: コンタクト: 全面Ni下地
 接触部: 0.38μm MIN金めっき
3. めっき: コンタクト: 全面Ni下地
 接触部: 0.76μm MIN金めっき
4. めっき: コンタクト: 全面Ni下地
 接触部: 2.0 μm MINスズめっき
5. めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部
 : ニッケル下地の上に半田めっき
6. めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部 : ニッケル下地の上にスズめっき

△6	△4	1,2-178293-5
△6	△3	1,2-178293-3
△6	△2	1,2-178293-2
(FINISH)		製品番号 (PART NO.)

C1	REVISED PER ECO-11-005030	RK	HMR	14 APR 11
LTR	REVISION RECORD	DR	CHK	DATE

DR.	20/MAR/95 K.IKEDA	DE.	20/MAR/95 K.IKEDA
CHK.	23/MAR/92 S. MANABE	APP.	23/MAR/92 S. MANABE

STE TE Connectivity			
3 POS SINGLE ROW HORIZONTAL HDR ASS'Y FOR DYNAMIC 3100			
一般公差 (GENERAL TOLERANCE)	SIZE	LOC	NUMBER
10mm : ±0.3 10mm 3mm : ±0.4 30mm 100mm : ±0.5 角度 : ±3'	A3	J	C=178293
SCALE	REV.	SHEET	
2-1	C1	1 OF 1	